

## IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

**Gniazda PCB Ethernetu jednoparowego**

Jednoparowy Ethernet to technologia wymagająca jednej pary przewodów do przesyłu danych i zasilania.

Zalety systemu zapewnią dominację standardu sieci SPE w zastosowaniach przemysłowych i nie tylko.

Zalety jednoparowego Ethernetu:

- Stabilność: jednoparowy Ethernet umożliwia standardową komunikację Ethernet od czujnika do chmury
- Potencjał rozwojowy: kluczowa technologia dla standardu Industry 4.0 oraz IIoT
- Uniwersalność: zakres do 1000 m i prędkość do 1 Gbps umożliwiają zastosowanie w wielu aplikacjach
- Innowacyjność: niska masa, mała wielkość i łatwa instalacja

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Wtyk montażowy, Wkładka M8 PCB, IP67 z obudową, Przyłącze lutowane SMD, 180°, Liczba biegunów: 2
Nr zam.	<a href="#">2795110000</a>
Typ	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
GTIN (EAN)	4064675119166
Ilość	100 Szt.

## IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	14,5 mm	Głębokość (cale)	0,571 inch
Wysokość	22,1 mm	Wysokość (cale)	0,87 inch
Szerokość	10,1 mm	Szerokość (cale)	0,398 inch
Masa netto	5,14 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C
----------------------------	----------------

## Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 63171-5
--------------------------------	-------------

## Właściwości elektryczne

Prąd znamionowy	4 A	Wytrzymałość izolacji	≥ 500 MΩ
napięcie znamionowe	72 V		

## Specyfikacje systemu

Cykle wpinania	≥ 100	Kategoria	T1-B
Klasa mocy	T1-B	Liczba biegunów	2
Proces lutowania	Lutowanie rozpułkowe, Lutowanie ręczny	Rodzina produktów	Industrial Ethernet
Stopień ochrony	IP67 z obudową	kąt odejścia	180°
montaż na płycie drukowanej	Przyłącze lutowane SMD		

## Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	LCP	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	Wytrzymałość izolacji	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał styków	Stop Cu	Powierzchnia styku	Ni/Au
Temperatura pracy, min.	-40 °C	Temperatura pracy, max.	85 °C

## Opakowanie

Długość VPE	327 mm	Szerokość VPE	327 mm
Wysokość VPE	52 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## IE-PCB-SPM-P-180-SMD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

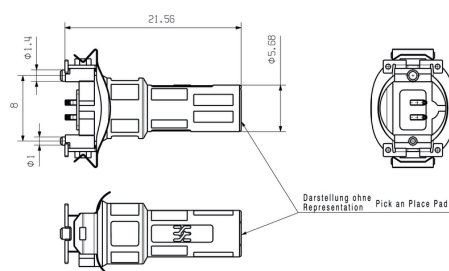
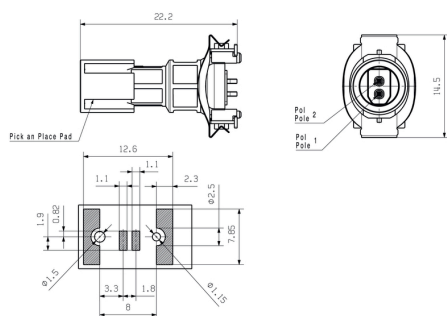
Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dokumentacja techniczna	<a href="#">IE-PCB-SPM-P-180-SMD</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-PCB-SPM-P-180-SMD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.